

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

МИЭМ.687253.001СБ

70.0*

10.9*

10.9*

27.9*

82.5*

29.2*

26.1*

2.5*

Ø3.2*

3 отв.

1. *Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, IT 12/2

3. Неуказанные предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий ±0,1 мм

4. Смещение центра металлизированного пояска относительно центра контактной площадки 0,1 мм

5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, условия эксплуатации по 3 группе жесткости. Класс точности – 5 по ГОСТ Р 53429-2009

6. Проводящий рисунок на плате проводить в соответствии с данными проектирования АБВГ.758722.001Т5М и данными конструкции АБВГ.758722.001Д1

7. Шероховатость обрабатываемой поверхности Rz40

8. Покрытие Пор HASL (Sn63Pb37 / ПОС63)

9. Финишное покрытие – жидкая фоточувствительная паяльная термоотверждаемая маска SunChemical XV501-T LDI, цвет зеленый

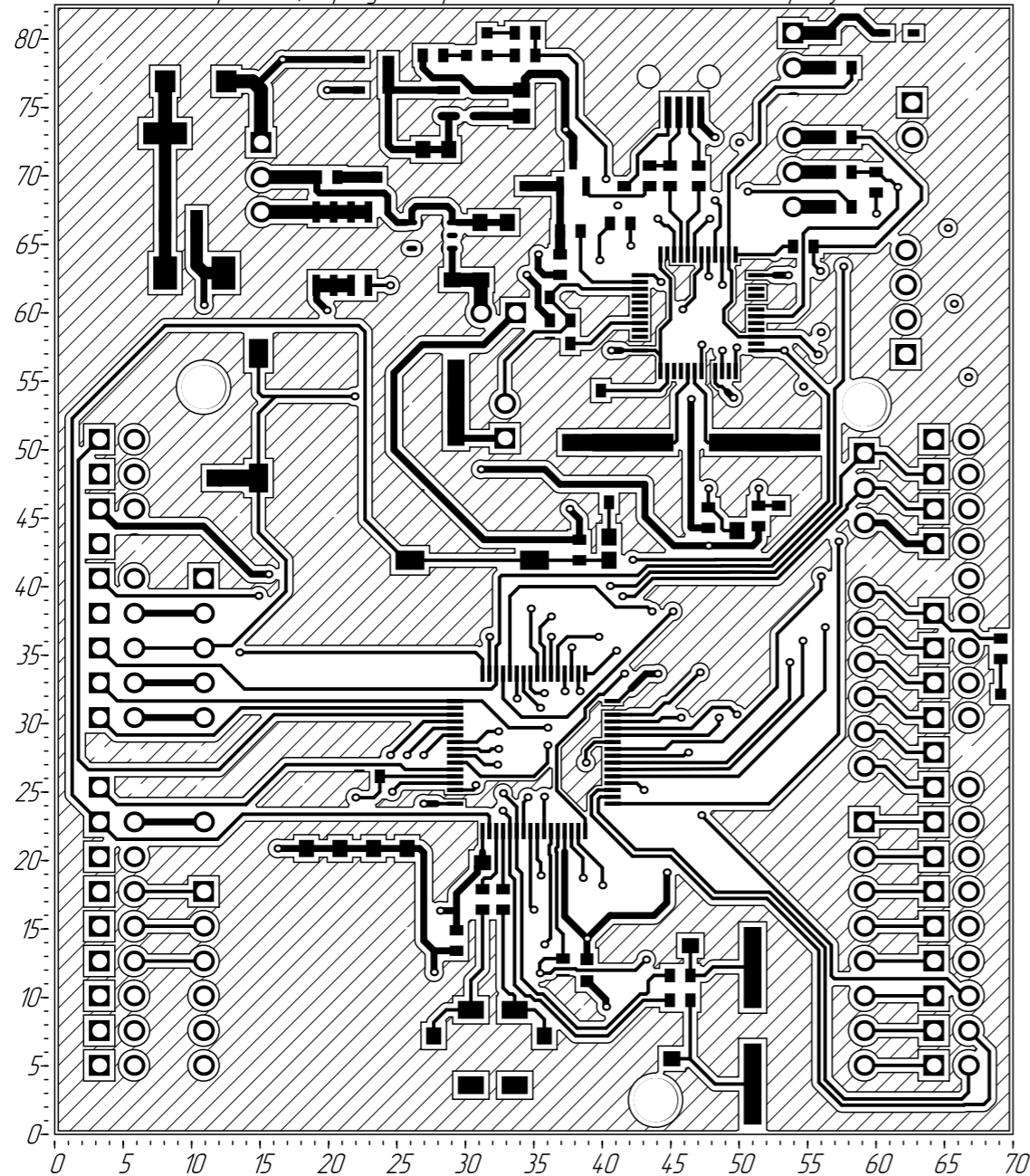
Рисунок 1 – Структура печатной платы

Материал	Слой	Толщина, мм
SunChemical XV501-T LDI	Top Solder	0.010
HASL (Sn63Pb37 / ПОС63)	Top Surface Finish	0.020
Медь	Top Layer	0.035
Стеклоткань FR4 TG150		0.115
CF-004	L2	0.035
Стеклотекстолит FR4 TG150		1.130
CF-004	L3	0.035
Стеклоткань FR4 TG150		0.115
Медь	Bottom Layer	0.035
HASL (Sn63Pb37 / ПОС63)	Bottom Surface Finish	0.020
SunChemical XV501-T LDI	Bottom Solder	0.010

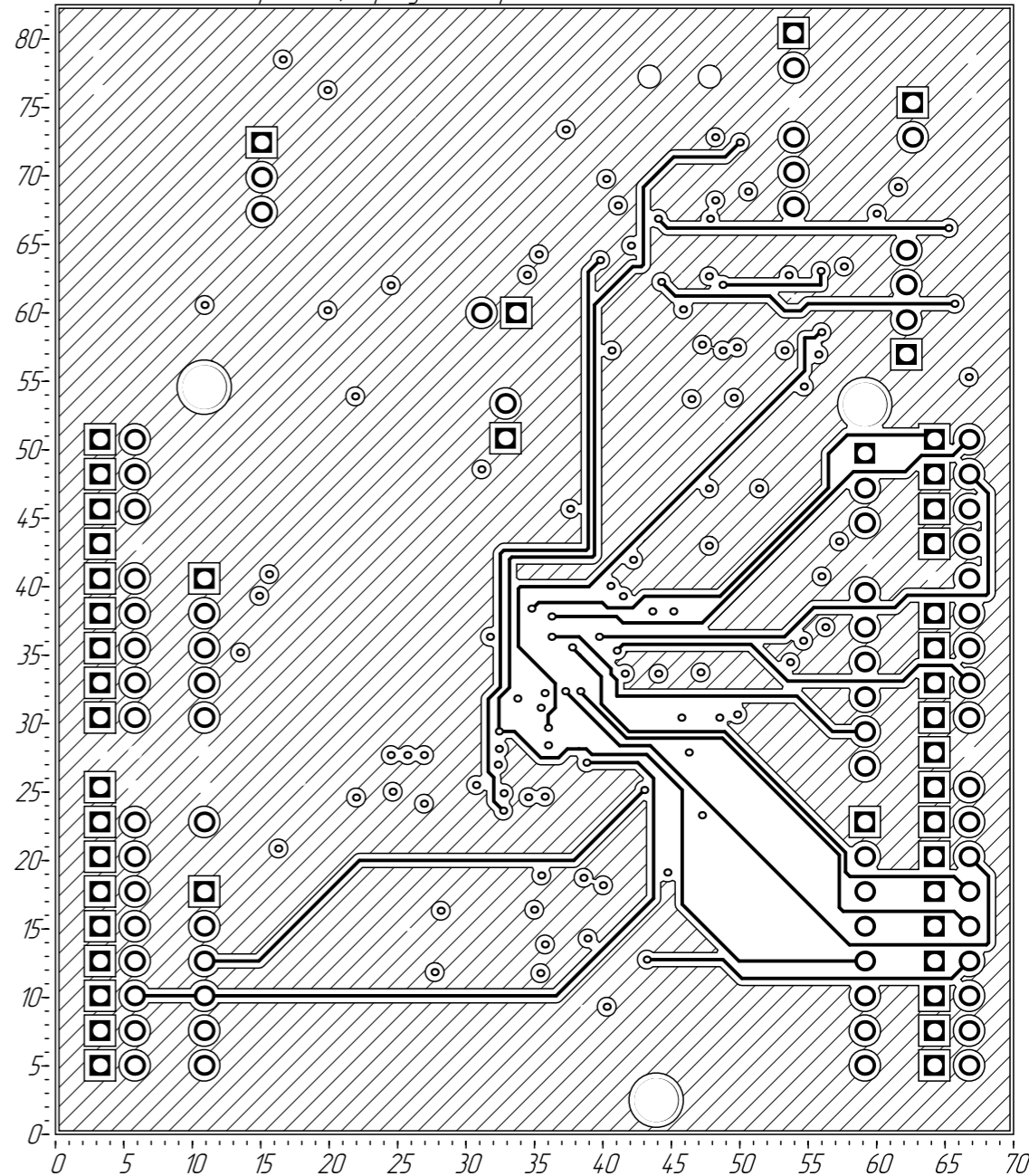
Общая толщина, мм: 1.560

					{Индекс заказчика}			
					МИЭМ.687253.001СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата печатная многослойная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Бадалян							1:1
Проверил								
Т. контр.								
Н. контр.					Сборочный чертёж	Лист 1	Листов 6	
Утв.								
Копировал					В	Формат А3		

Проводящий рисунок верхнего слоя печатной платы – Top Layer



Проводящий рисунок второго слоя печатной платы – L2



Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

В

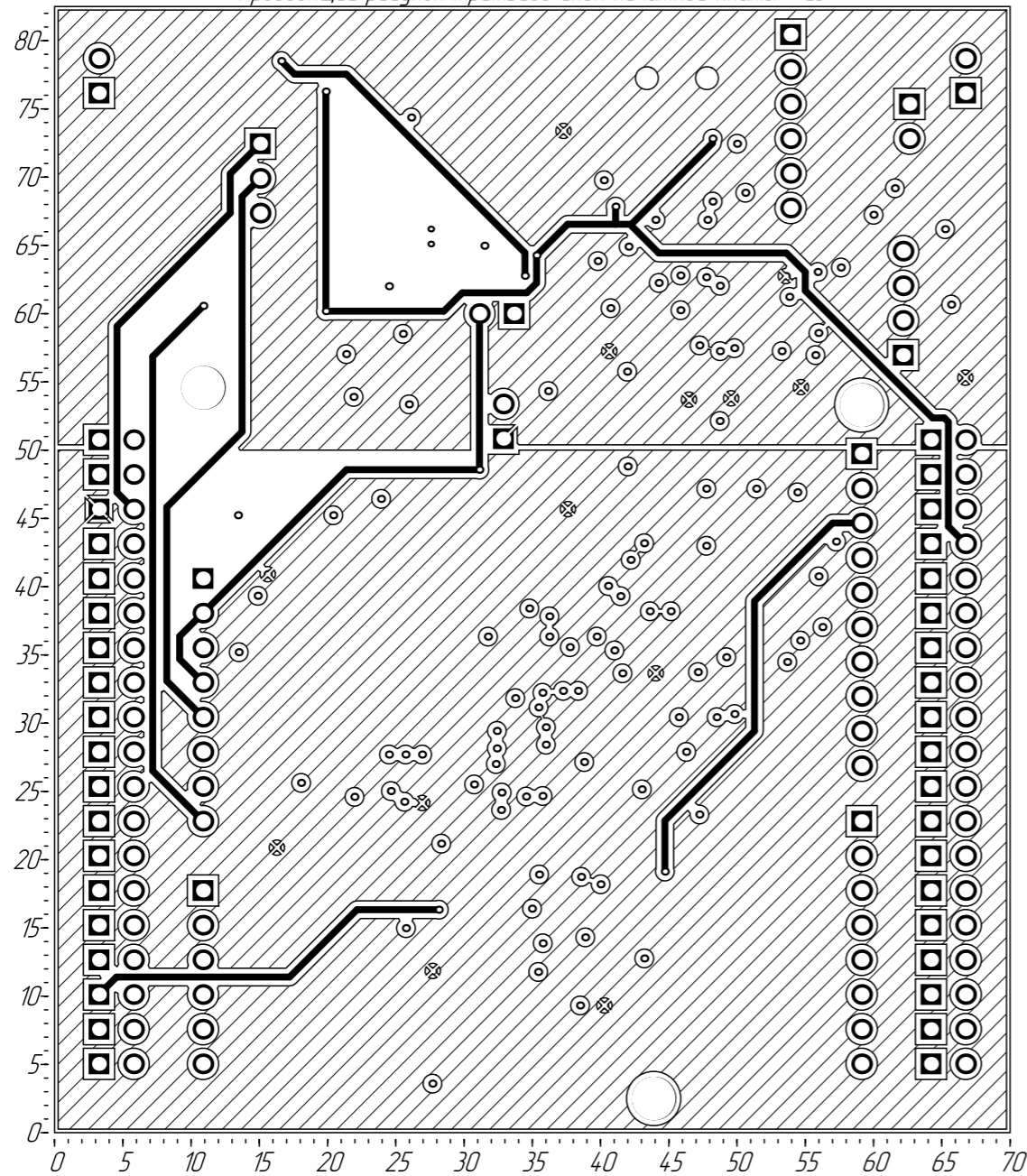
Формат А3

МИЭМ.687253.001СБ

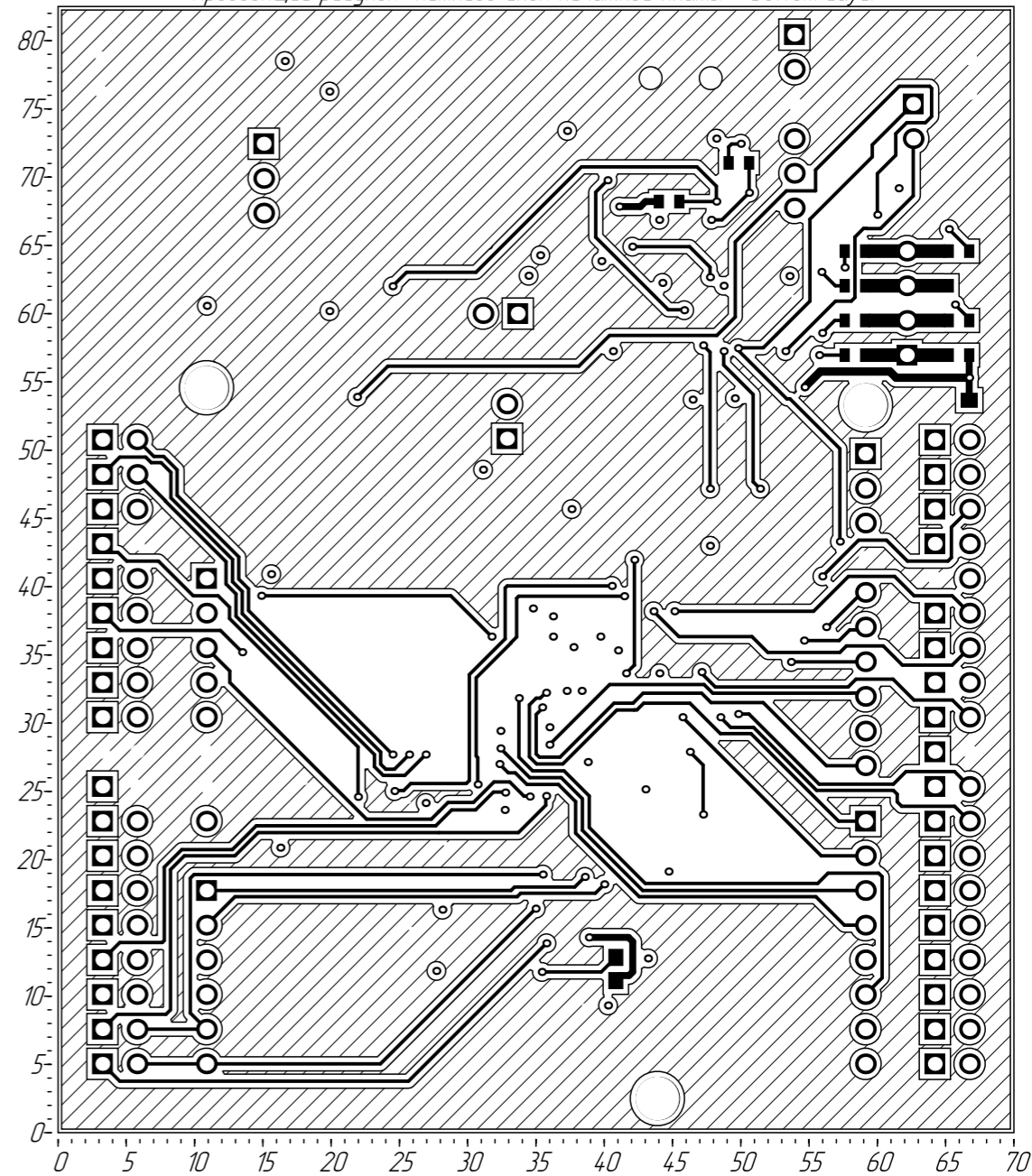
2

Лист

Проводящий рисунок третьего слоя печатной платы - L3



Проводящий рисунок нижнего слоя печатной платы - Bottom Layer

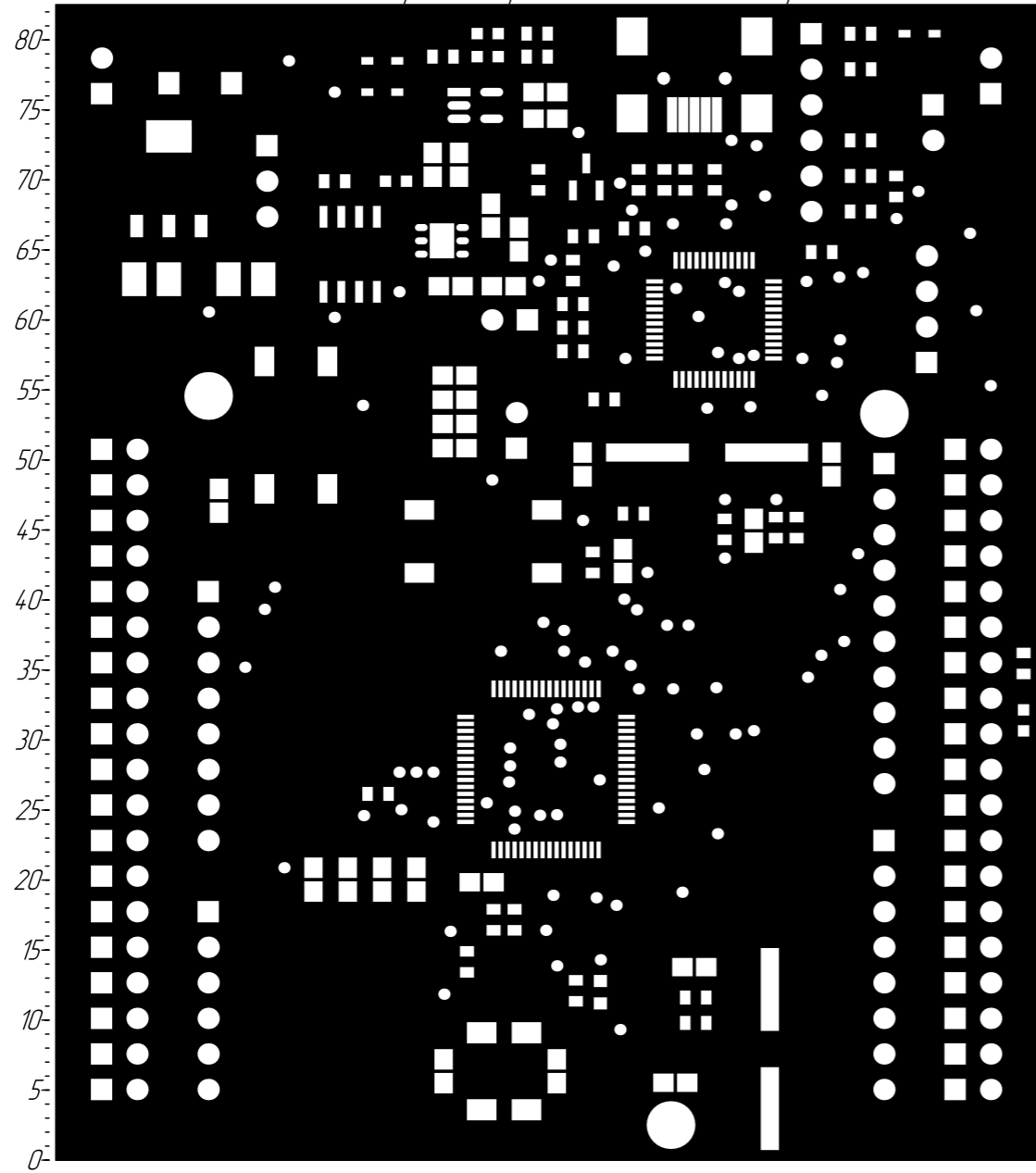


Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № подл.	Подп. и дата

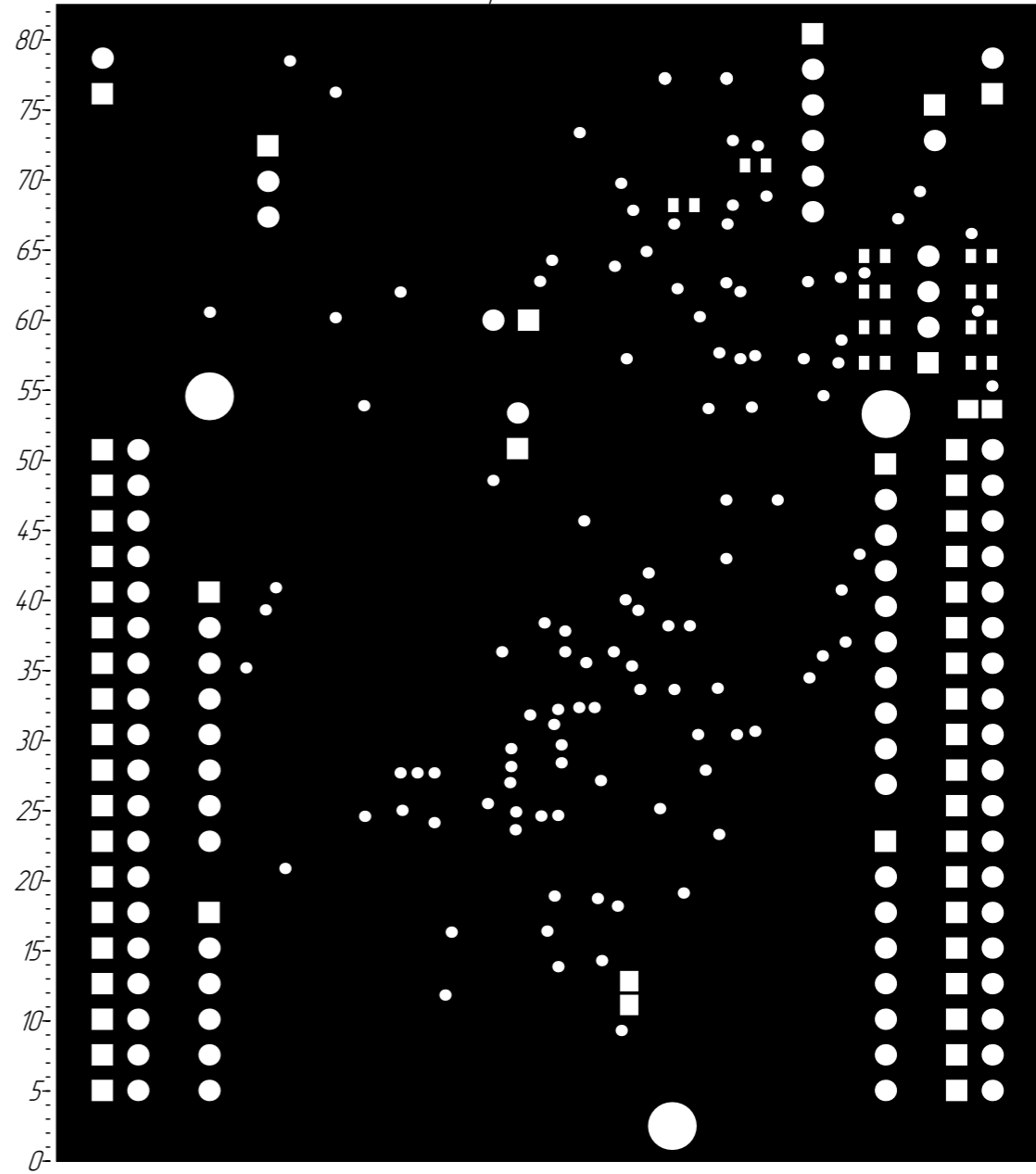
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МИЭМ.687253.001СБ

Масочный слой верхней стороны печатной платы – Top Solder



Масочный слой нижней стороны печатной платы – Bottom Solder

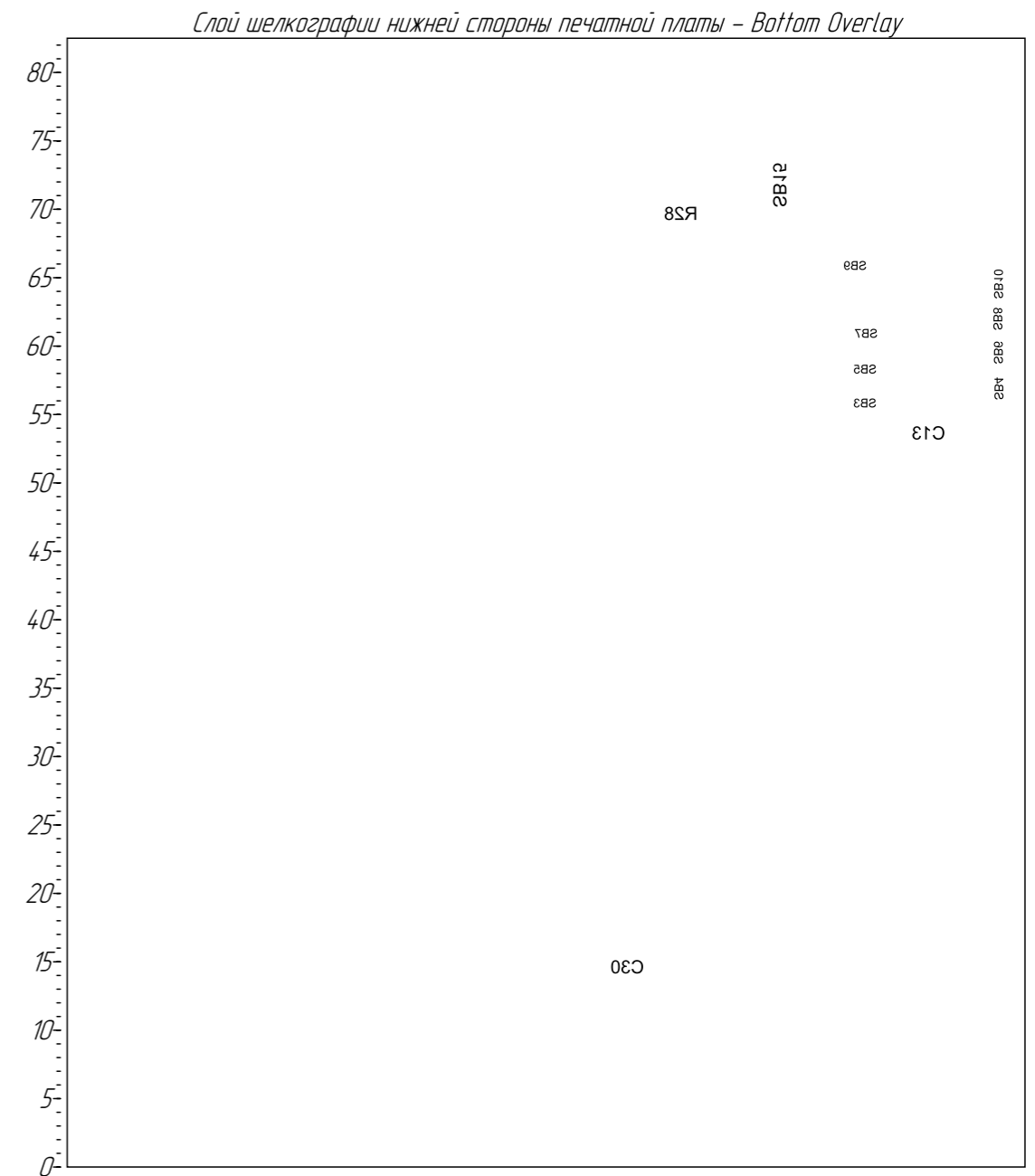
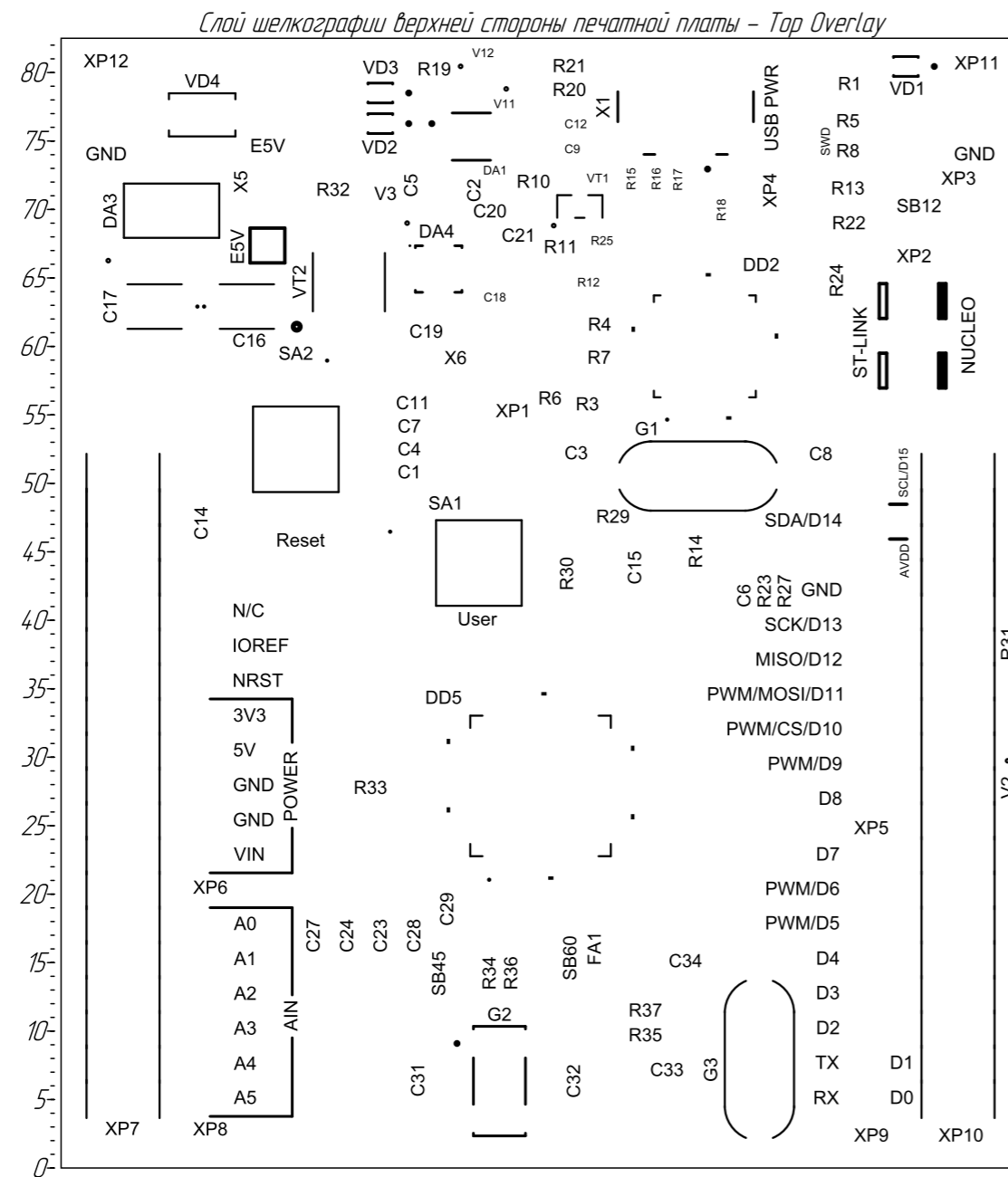


Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МИЭМ.687253.001СБ

MM3M.687253.001CB



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № подл.	Подп. и дата

МИЭМ.687253.001СБ

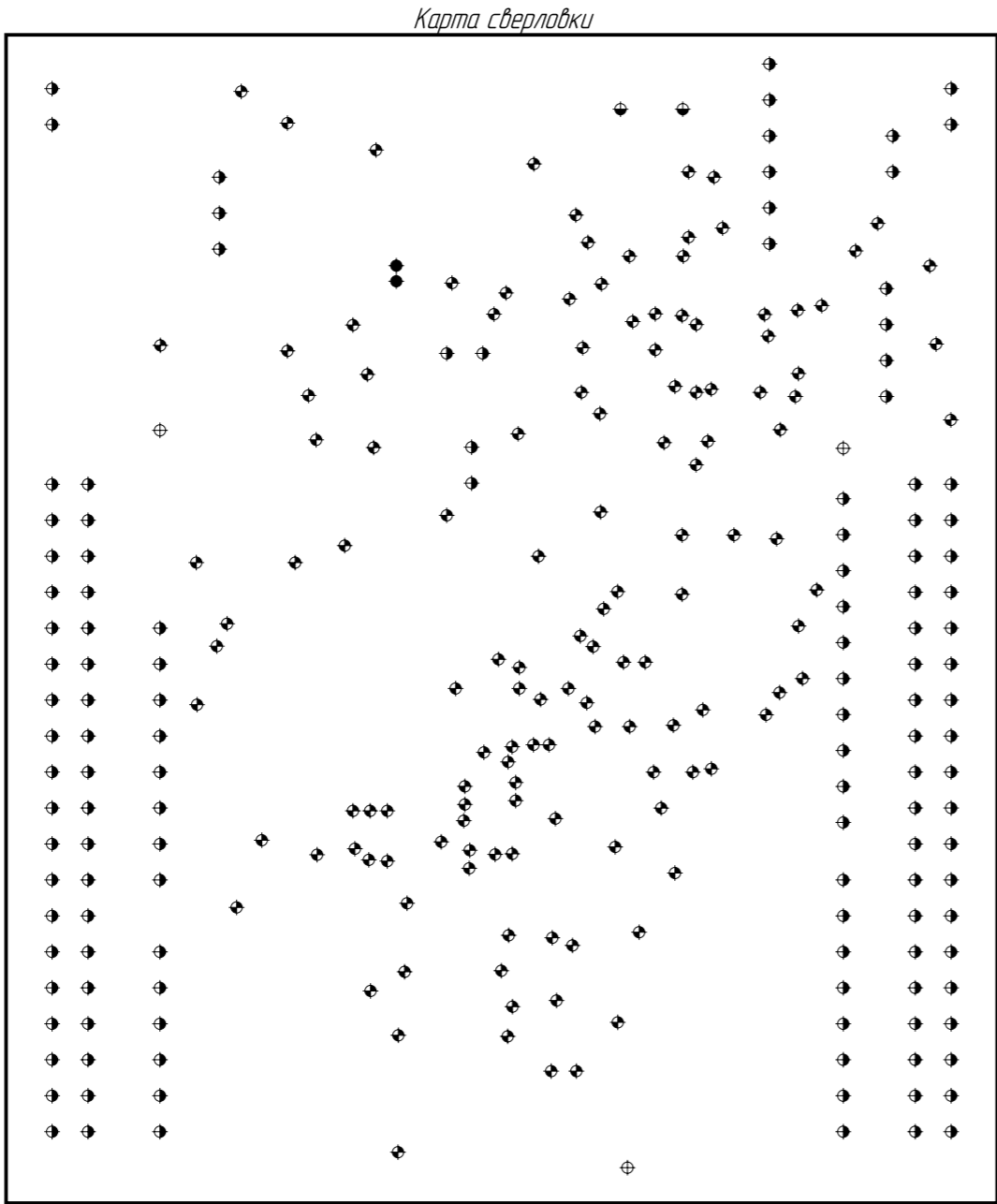


Таблица отверстий

Обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Установлен	Количество отверстий
●	0.20	Есть	2
⊕	0.30	Есть	134
⊕	0.90	Нет	2
⊕	102	Есть	131
⊕	3.20	Есть	3
			272 Total

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МИЭМ.687253.001СБ